

台法攜手打造軟硬融合的創新經濟效益

# 工研院與達梭系統 跨界創新合作

工研院與達梭系統簽署合作備忘錄，為台、法之間的創新合作樹立新里程碑，攜手打造軟硬融合的創新經濟效益。

撰文／陳宣伊 圖片提供／工研院

響應政府「連結全球」推動五加二產業創新計畫，工研院日前與國際知名大廠達梭系統（Dassault Systemes）在其法國巴黎總部簽署合作備忘錄，由經濟部技術處科技專家張嘉祥見證，工研院副院長張培仁與達梭系統資深副總裁 Bertrand SICOT 代表簽署。未來雙方將針對「物聯網」與「未來工廠」兩大主題，分別就積層製造、智慧城市等相關技術領域展開合作。

「我們希望能夠以工研院在 IoT、智慧製造等技術的研發能量，結合達梭系統在 3D 模擬和模型軟體的豐富經驗，進一步建立雙贏的合作關係，共創新興產業商機。」代表工研院簽約的張培仁表示，達梭系統是全球 3D 體驗產品的軟體程式開發領導廠商，也是全球擁有 10 萬多名客戶、遍及 80 餘國的商業價值創造者；面對台灣產業升級轉型的關鍵時刻，工研院扮演著創新引擎的重要角色，積極協同國內企業與國產學研機構合作，帶動新興產業與生態體系發展，加速切入國際市場。

張培仁進一步指出，台灣無論在 ICT 產業的產品、半導體製造、IC 設計、或面板等領域，均在世界占有舉足輕重地位，近期在物聯網、智慧城市和先進製造等也獲致良好成果。此外，今年初，智慧城市論壇（Intelligent Community Forum；ICF）公布全球 Top 7 智慧城市名單中，台灣有二縣市入榜，展現台灣於智慧城市的發展實力已獲國際肯定。此次工研院與達梭系

統的合作，不僅為台、法之間的創新合作樹立新里程碑，也將促成更多台、法產業合作機會。

達梭系統資深副總裁 Bertrand SICOT 強調，自 1981 年成立以來，達梭系統一直是 3D 軟體的先驅，全球所有飛機製造商都是達梭系統解決方案使用者，超過 90% 的主要汽車製造商也是達梭系統的客戶，達梭系統致力發展能夠協助各種用戶改善產品設計開發的解決方案。他希望本次合作能透過工研院的前瞻創新研發專長，共同開發高附加價值之技術、產品及服務。■



由工研院副院長張培仁（左）與達梭系統資深副總裁 Bertrand SICOT（右）共同簽署合作備忘錄，未來雙方將針對「物聯網」與「未來工廠」兩大主題，分就積層製造、智慧城市等相關技術領域展開合作。